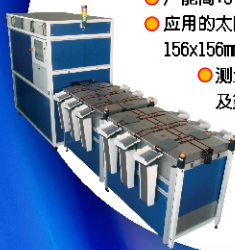


Control Your Wafer Quality

SNEC PV 5/6-5/8
POWER EXPO 2009
See us at Booth #T658 - Hall E6

hennecke
systems

太阳光伏电池专用硅片检测分类机 Wafer Metrology Sorter



- 产能高: 3,400片/时 (156x156mm)
- 应用的太阳光伏电池硅片尺寸: 125x125mm和 156x156mm (标准), 也有210x210mm可供选配
- 测量太阳光伏芯片的厚度, 厚度差及翘曲度
- 检验太阳光伏电池硅片的尺寸、电阻率、少子寿命、两面线痕、边缘缺陷、缺口和破片、隐裂检测

HE-WI-04



PRIME

芯片型热电偶温度计 Wafer Thermocouple

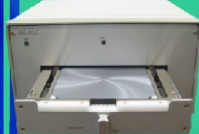
Wafer T/C

- 供半导体设备测量温度 Profile, 品质符合 ISO9003 标准
- 适用于 Hot Plate, Ovens, RTP, RTA, Sputtering, CVD, Reflow 之制程温度测量
- 依客户需求规格订作, 价格低廉, 并提供售后服务
- 另提供光罩型, GaAs Wafer 及 LCD 热电偶计等多种产品



非接触式芯/硅片量测仪 E+H Wafer Geometry Gauge (Semiconductor/Solar)

- 非接触式电容感应量测方式
- 最小刻度为 0.1um, 重复性误差 0.25um



- 测量时间 5sec./wafer
- 可量测 Thickness,
- Flatness, Warp, Bow
- 支援 WaferMap 3D 功能

G&N

内圆切割机 Inner Diameter Saw



IDS 34

- 单晶硅棒, 多晶硅块切头尾专用
- 钻石锯片, 以水做冷却液, 不需砂液
- Curf Loss 硅材料损失低
- 切速快, 高产能, 高良率
- 最大可切 8" 单晶或 156mm 多晶, 长度达 570mm

G&N

太阳光伏硅棒研磨抛光机 Solar Brick Grinder



- 研磨抛光太阳光伏单晶及多晶硅棒
- 硅棒表面破坏深度 (S.S.D.) 最小化
- 大幅降低多线切割硅棒破片率 1~3%
- 高产能—研磨硅棒四面及斜角仅 25 分钟

MPS 3-134



光学式芯片厚度/翘曲度量测仪 Non-Contact Layer Thickness Measurement



SemDex 301

- 适用于 Bumped Wafer, Multifoils Wafer in Packaging, Photoresist Layer, MEMS SOI, GaAs, Glass
- 可同时显示多层不同材料厚度 (最多 8 层)
- 量测光点直径最小 (min. 20um)
- 单一机台同时适用多种不同芯片尺寸 (2" ~ 12")
- 另选配可量测电池片翘曲度及内应力 Stress

Chunson

冲成有限公司
JC's Chunson Limited

TEL: +86-21-6251-5152 Http:// www.chunson.com
FAX: +86-21-6212-7410 E-mail: info@chunson.com